

Precision Metals – NIC 3.0

Fingerstock and Custom Clip Opportunities

Laird leads the industry in Fingerstock and Custom Metal Clip design expertise and technologies. This is widely recognized in the marketplace and one of the reasons why Laird was chosen as a supplier for precision metal components in the Open Compute Project (OCP) – NIC 3.0.

The Open Compute Project (OCP) is a collaborative community focused on redesigning hardware technology to efficiently support the growing demands on compute infrastructure. Community partners include: Facebook, HP, Intel, AMD, Broadcom, Google, Huawei, Microsoft, LinkedIn, AT&T, Verizon, Nokia, etc.

One specific project that is being worked on by OCP is called NIC 3.0. NIC 3.0 specification defines a third-generation mechanical form factor that allows for interoperability between compliant baseboards and OCP NIC 3.0 cards. In addition, NIC 3.0 is addressing the limitations currently being experienced with NIC 2.0 such as board space, mechanical profile, connector placement, and specification quality. Two different form factor modules will be included in NIC 3.0, a small form factor (SFF) and a large form factor (LFF) – see Figures 1 and 2 for 4X SFP version examples. For additional NIC 3.0 information click this link:

[HTTPS://WWW.OPENCMPUTE.ORG/WIKI/SERVER/MEZZ](https://www.opencompute.org/wiki/server/mezz)

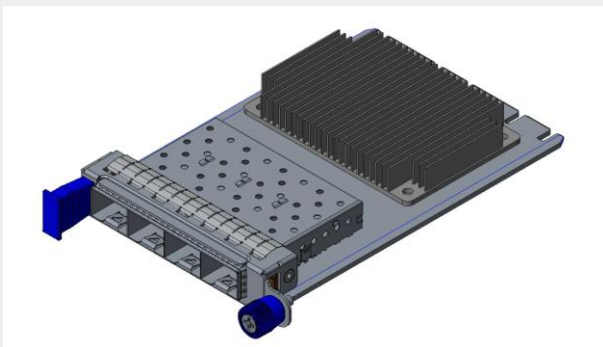


Figure 1 – NIC 3.0 SFF Module (4X SFP version)

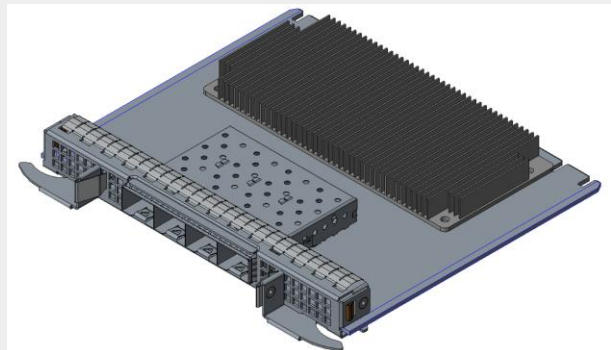


Figure 2 – NIC 3.0 LFF Module (4X SFP version)

The modules will include both fingerstock and side spring parts (Figure 3) and then the modules will get inserted into a chassis (Figure 4). Laird has worked with the OCP community to have Laird's part numbers stated in the NIC 3.0 specification so the large number of companies that will adopt to this specification can place orders directly with Laird for the parts.

The parts are in inventory at all the regional sampling centers for quick 24-hour turn on prototypes. Table 1 states the Laird part numbers by each module form factor type. In addition, hard tooling is already in place in Shenzhen to support larger quantity orders.

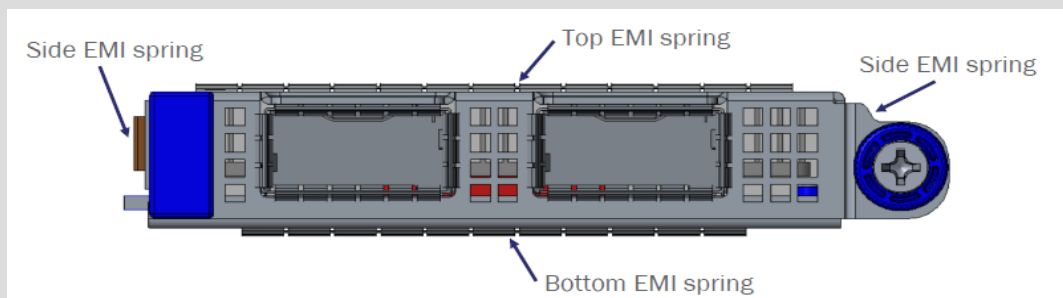


Figure 3 - Example of a 2X QSFP version module showing the location of the fingerstock and side springs.

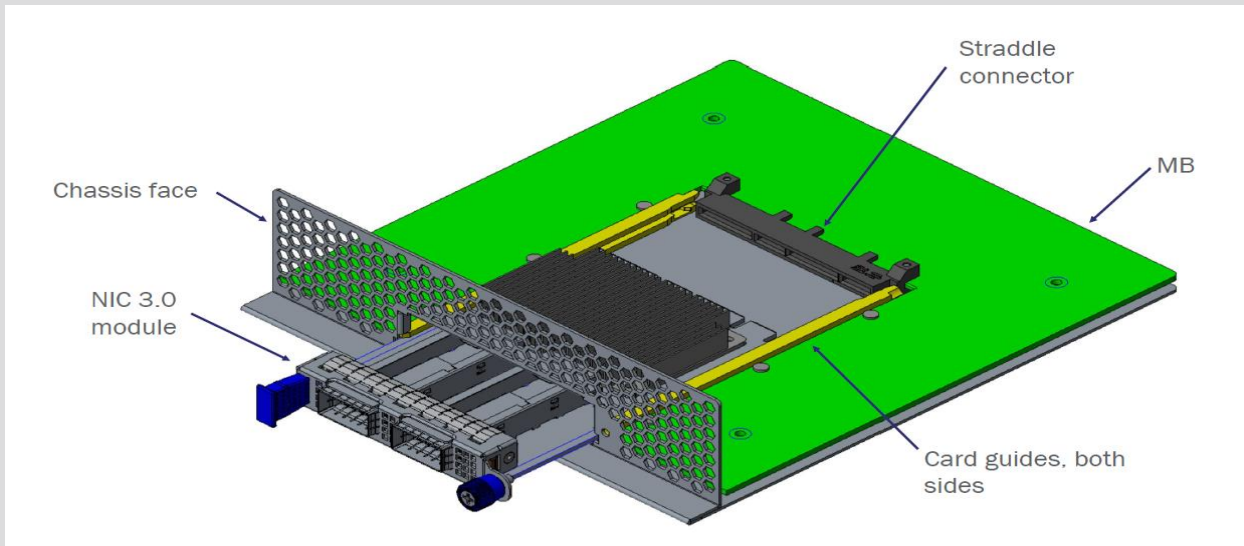


Figure 4 – NIC 3.0 module including chassis example

Laird Part Number	Description ⁽¹⁾	Module Form Factor	Qty Per
LT18CJ4430	Be/Cu Fingerstock – 9 fingers	SFF w/ Ejector Latch	1
LT18CJ1920	Be/Cu Fingerstock – 11 fingers	SFF w/ Internal Lock or Pull Tab	1
LT18CJ1921	Be/Cu Fingerstock – 13 fingers	SFF w/ Ejector Latch, Internal Lock, or Pull Tab	1
LT18DP1911	Be/Cu Side Clips	SFF w/ Ejector Latch, Internal Lock, or Pull Tab	2
LT18CJ1922	Be/Cu Fingerstock – 25 fingers	LFF w/ Ejector Latch	1
LT18CJ1923	Be/Cu Fingerstock – 27 fingers	LFF w/ Ejector Latch	1
LT18DP1911	Be/Cu Side Clips	LFF w/ Ejector Latch	2

Table 1 – Part Number List

(1): If Be-Free is a requirement, alternative materials such as Recyclable Clean Copper (RCC) are available for testing and evaluation.



USA: +1.866.928.8181
Europe: +49.8031.24600
Asia: +86.755.2714.1166
www.lairdtech.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.